



# 中華民國專利證書

發明第 I 867410 號

發明名稱：晶粒封裝結構

專利權人：力勤股份有限公司

發明人：廖皇順

專利權期間：自 2024 年 12 月 21 日至 2043 年 1 月 15 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

廖承威

中華民國 113 年 12 月 21 日

